

	证券、东北证券、长江证券、西南证券、上海证券、浙商证券、中信证券、开源证券、东吴证券、中泰证券、安信证券、兴业证券、财通证券、汇丰前海证券、海通证券、国金证券、国盛证券、华兴证券、万联证券、太平洋证券、野村东方国际证券、国联证券、东方证券、瑞信证券、中信建投证券、华安证券、个人投资者（排名不分先后）
时间	2023年4月28日10:00
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：蒋威 证券投资部：王渝、陈小曼、陈卓璜
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、公司 2023 年第一季度经营情况介绍</p> <p>受限于行业层面需求不振、竞争加剧的压力，一季度净利润受费用拖累有所下滑。报告期内，公司实现营业收入 125,175.52 万元、同比下降 1.63%、环比增长 4.11%；归属于上市公司股东的净利润 750.35 万元、同比下降 96.27%、环比增长 4.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 92.00 万元、同比下降 99.24%、环比增长 120.55%。第一季度毛利率为 24.15%，同比下降 5.52 个百分点，环比下降 1.40 个百分点。</p> <p>公司一季度净利润同比大幅下滑主要受封装基板项目拖累，其中，CSP 封装基板项目受制于下游需求不振，产能利用率较低导致整体亏损；FCBGA 封装基板项目整体仍处于投入初期，人工成本、电费及物料成本投入较大，整体研发费用投入同比增加约 6,000 万元；员工持股计划一季度费用摊销约 765 万元。</p> <p style="text-align: center;">二、IC 封装基板竞争展望及下游布局</p> <p>2022 年，全球 PCB 行业产值为 817.40 亿美元、同比仅增长 1.00%。其中，IC 封装基板行业整体规模达 174.15 亿美元、同比增长 20.90%，为 PCB 行业中增速最快的细分子行业。中国市场 IC 封装基板行业（含外资厂商在国内工厂，下同）整体规模为 34.98 亿美元、同比增长 33.40%，仍维持快速增长的发展态势。</p> <p>CSP 封装基板目前国内内资企业仅有少数几家具备量产能力和稳定的客源；FCBGA 封装基板也仅有少数几家实际投资扩产，国内产业链供需格局预期仍乐观，不排除会有新进入者，但公司现阶段主要聚焦于自身，</p>

修炼内功、提升能力，一方面持续加大研发投入和客户开拓，另一方面，持续稳步推进 FCBGA 封装基板项目的投产和良率提升，来强化公司整体的竞争力和抗风险能力。

三、FCBGA 封装基板项目的进展情况

珠海 FCBGA 封装基板项目拟建设产能 200 万颗/月（约 6,000 平方米/月）的产线，已于 2022 年 12 月底建成并成功试产，目前良率持续提升，预计 2023 年第二季度开始启动客户认证，第三季度进入小批量产品交付阶段。

广州 FCBGA 封装基板项目拟分期建设 2000 万颗/月（2 万平方米/月）的产线，一期厂房已于 2022 年 9 月完成厂房封顶，预计 2023 年第四季度完成产线建设、开始试产。

现阶段公司着力于产品研发及良率提升工作，有序推进 FCBGA 封装基板项目建设进程。

四、CSP 封装基板发展预期介绍

存储芯片行业是公司 CSP 封装基板领域最大的下游市场，收入占比约 2/3，指纹识别芯片、射频芯片、应用处理器芯片、传感器芯片等其他相关领域占比约 1/3。受行业景气度低迷及消费电子去库存影响，CSP 封装基板需求不振，2022 年 Q4 和 2023 年 Q1 公司 CSP 封装基板业务产能利用率不高导致整体亏损，从 4 月份开始订单有所回暖，未来 CSP 封装基板项目的经营效益主要取决于整体需求复苏的情况。

五、公司传统 PCB 业务介绍

公司样板、小批量板业务客户集中度低，公司客户多为下游多个行业领先企业或龙头企业，客户所涉行业较广，不依赖单一行业、单一客户，受下游大客户或单一行业周期、经济周期影响小。业务产品下游应用占比如下：通信约占 1/3，服务器、安防各占 15%~20%，工控、医疗各占 10%左右，其他行业约占 15%。

宜兴批量板主要为 8 层以上高、多层线路板，主要应用于 5G、光模块、服务器、安防等领域，目前已在通信和服务器领域的大客户端实现量产突破，但受制于下游需求不振及竞争加剧，毛利率水平有所下降。

六、北京收购项目的进展介绍

	<p>目前公司正积极推进对标的公司揖斐电电子（北京）有限公司的审计、业务对接等工作。待审计工作完成后，交易双方将根据《股权购买协议》约定的价格调整机制，对基础购买价格进行调整，公司将及时召开董事会审议相关事项。</p> <p>七、公司后续扩产计划介绍</p> <p>受国际形势复杂化、行业景气度低迷等因素影响，宏观经济受到一定冲击，也对公司新扩产能的释放产生了一定影响。在传统 PCB 领域的重点将放在数字化改造，通过建立管理标准，借助先进的数字化技术手段，从设计、制造、仓储、物流实现全面数字化管理，在质量、技术、交期等环节提升传统 PCB 业务的竞争力，实现平稳增长。半导体业务方面，CSP 封装基板将在现有产能满产后启动扩产计划；FCBGA 项目将继续按计划推进建设进程。</p> <p>八、今年外部影响大，如何看待产业趋势？</p> <p>从行业需求判断，2023 年 PCB 行业应该是前低后高趋势，逐季环比改善，整体回暖幅度取决于宏观经济复苏的力度。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 4 月 28 日